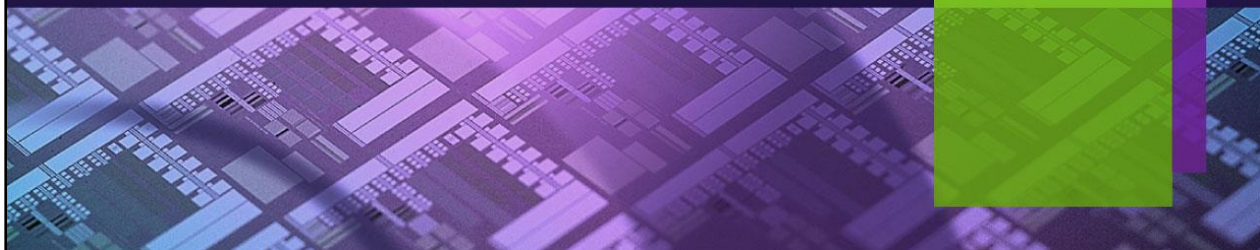


2026年3月期 第2四半期（2025年7月～9月） 東京エレクトロン 決算説明会

2025年10月31日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

2026年3月期 第2四半期 連結決算の概要

2025年10月31日

常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー
川本 弘



改めまして、川本でございます。
私から、2026年3月期、第2四半期 連結決算の概要 をご説明いたします。

損益状況（四半期）

(億円)

	FY2025			FY2026		vs. FY2026 Q1	vs. FY2025 Q2
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2		
売上高	5,665	6,545	6,554	5,495	6,300	+14.6%	+11.2%
売上総利益	2,599	3,117	3,105	2,539	2,848	+12.2%	+9.6%
売上総利益率	45.9%	47.6%	47.4%	46.2%	45.2%	-1.0pts	-0.7pts
販管費	1,117	1,121	1,267	1,092	1,264	+15.7%	+13.1%
営業利益	1,481	1,996	1,837	1,446	1,584	+9.5%	+6.9%
営業利益率	26.2%	30.5%	28.0%	26.3%	25.1%	-1.2pts	-1.1pts
税金等調整前当期純利益	1,536	2,001	1,851	1,519	1,610	+6.0%	+4.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,177	1,572	1,429	1,178	1,238	+5.1%	+5.2%
研究開発費	620	618	727	621	726	+17.0%	+17.1%
設備投資額	533	502	346	528	912	+72.7%	+71.1%
減価償却費	145	160	183	171	191	+11.4%	+31.8%

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。
3. FY2025は2024年4月～2025年3月の会計年度を指しています。FY2026は2025年4月～2026年3月の会計年度を指しています。

こちらは、四半期ごとの「損益状況」です。青枠の部分を中心にご覧ください。

第2四半期の売上高は、計画どおり進捗し、前四半期比 14.6%増加の 6,300億円となりました。

売上総利益は、前四半期比12.2%増加の2,848億円。

売上総利益率は、固定費比率の上昇等により、前四半期比1.0ポイント減少の45.2%となりました。

営業利益は、前四半期比9.5%増加の、1,584億円。

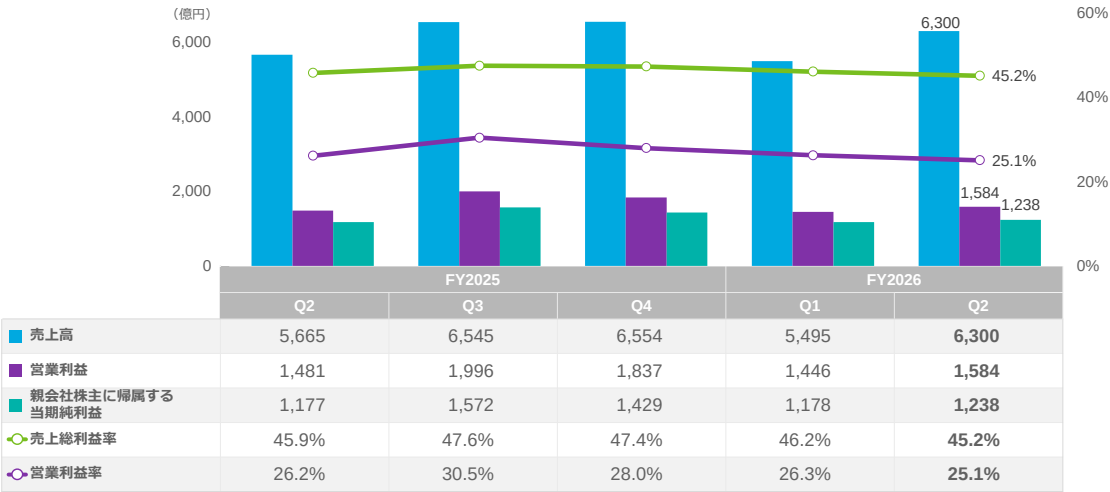
営業利益率は、開発費増加等の影響により、前四半期比1.2ポイント減少の25.1%となりました。

税金等調整前当期純利益は、前四半期比6.0%増加の1,610億円、また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前四半期比 5.1%増加の 1,238億円となりました。

第2四半期の設備投資額は912億円でした。

東京エレクトロン宮城の新生産棟の着工時の支払、先般竣工した東京エレクトロン九州の開発棟などが主な内訳でございます。

損益状況（四半期）



こちらのグラフは、先ほどご説明させていただいた業績を時系列で示しておりますので、ご確認ください。

損益状況（半期）

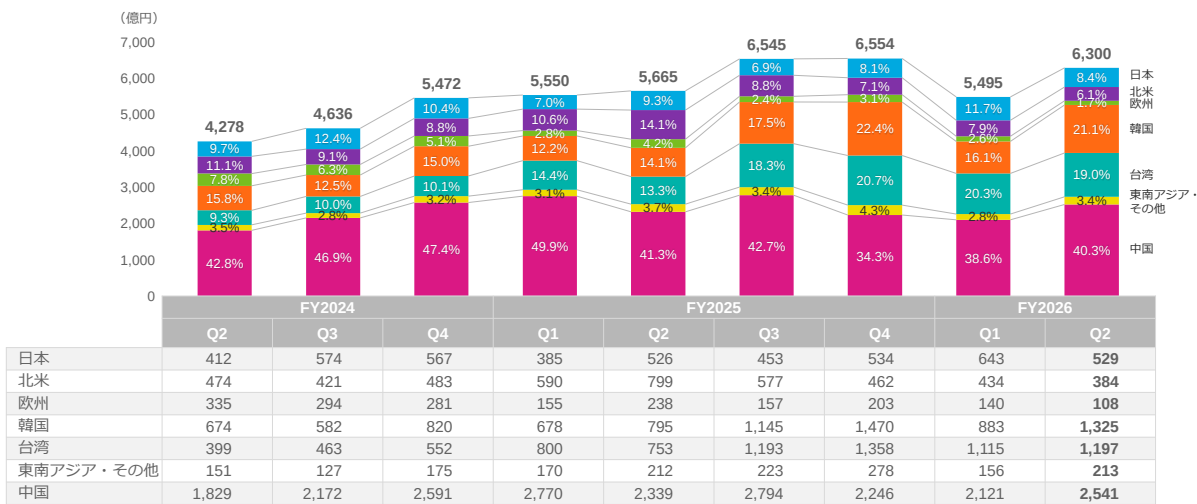
(億円)

	FY2025		FY2026	vs. FY2025 H2	vs. FY2025 H1	(ご参考) 7月31日発表 FY2026 H1 予想
	H1	H2	H1			
売上高	11,216	13,099	11,796	-9.9%	+5.2%	11,500
売上総利益	5,239	6,223	5,388	-13.4%	+2.8%	5,270
売上総利益率	46.7%	47.5%	45.7%	-1.8pts	-1.0pts	45.8%
販管費	2,100	2,389	2,357	-1.3%	+12.2%	2,390
営業利益	3,139	3,834	3,031	-20.9%	-3.4%	2,880
営業利益率	28.0%	29.3%	25.7%	-3.6pts	-2.3pts	25.0%
税金等調整前当期純利益	3,208	3,852	3,129	-18.8%	-2.5%	2,930
親会社株主に帰属する当期純利益	2,439	3,002	2,416	-19.5%	-0.9%	2,240
研究開発費	1,154	1,345	1,348	+0.2%	+16.7%	1,400
設備投資額	773	848	1,440	+69.8%	+86.4%	-
減価償却費	277	344	362	+5.3%	+30.9%	-

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

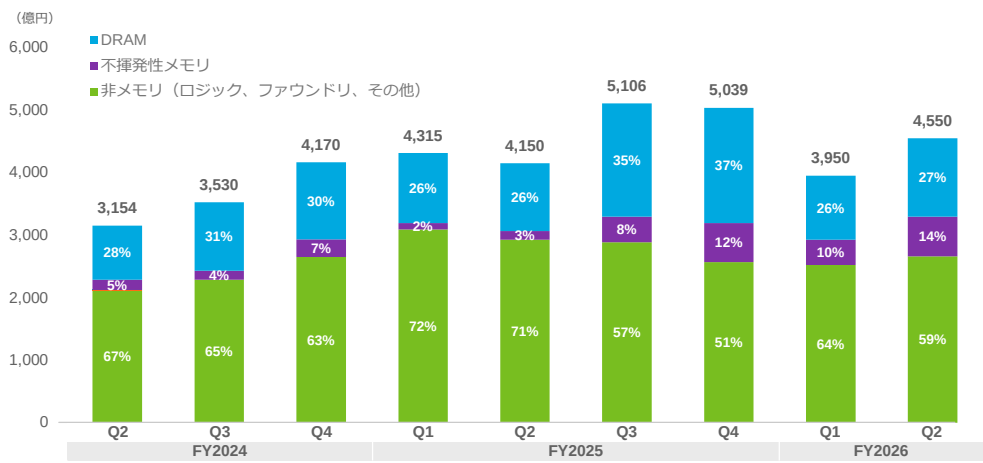
こちらは半期ベースの業績を示しております。
青枠で囲っている箇所が、今上期の損益状況でございます。
一番右に、7月31日に発表しました今上期の業績予想数値を表示しております。
ご覧のとおり、ほぼすべての項目で計画を上回る結果となりました。

地域別売上高構成比（四半期）



こちらは、「地域別売上高」です。
第2四半期の構成比につきましては、韓国で前四半期比5ポイント増加し21.1%となりました。
中国向けの売上高構成比につきましては、一部下期からの前倒しの傾向もみられ、第2四半期の比率は40.3%となりました。

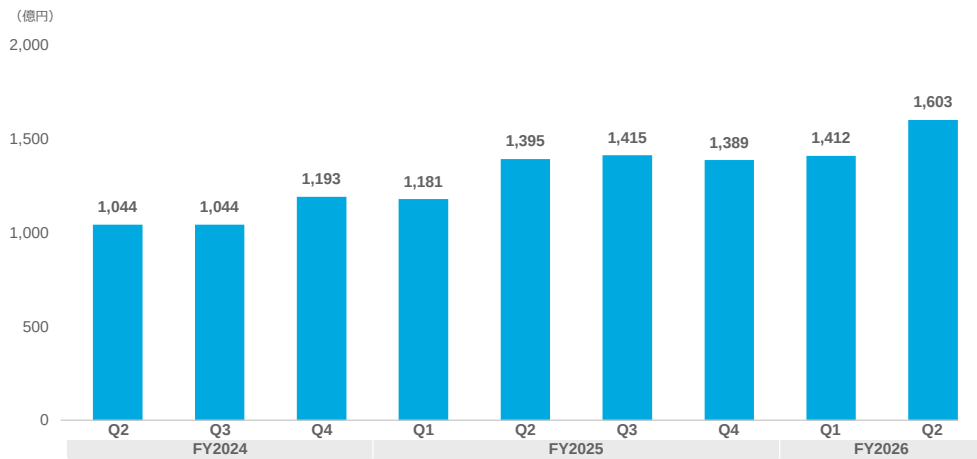
SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置
2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

こちらは、「SPE新規装置のアプリケーション別 売上構成比」です。
第2四半期の構成比は、下から非メモリ 59%、不揮発性メモリ 14%、DRAM 27%となりました。
SPE新規装置の売上・アプリケーション別の比率は、概ね上期の想定どおりに推移いたしました。

フィールドソリューション売上高（四半期）

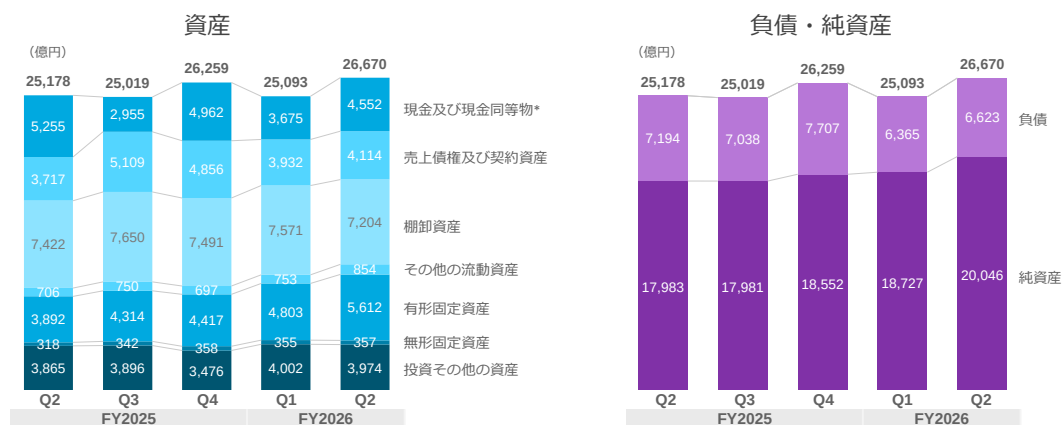


こちらは、「フィールドソリューション売上高」です。

第2四半期は、1,603億円となりました。

顧客稼働率は高まっており、直近四半期はサービス等が堅調に推移した他、改造案件も増加し、前四半期比191億円の増加となりました。

貸借対照表（四半期）



*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

続きまして、「貸借対照表」をご説明いたします。

資産合計は、2兆6,670億円となりました。

現金同等物は、4,552億円。前四半期から877億円増加いたしました。

売上債権及び契約資産は、前四半期比181億円増加の4,114億円。

棚卸資産は、工場の在庫の減少もあり、前四半期比366億円減少の7,204億円。

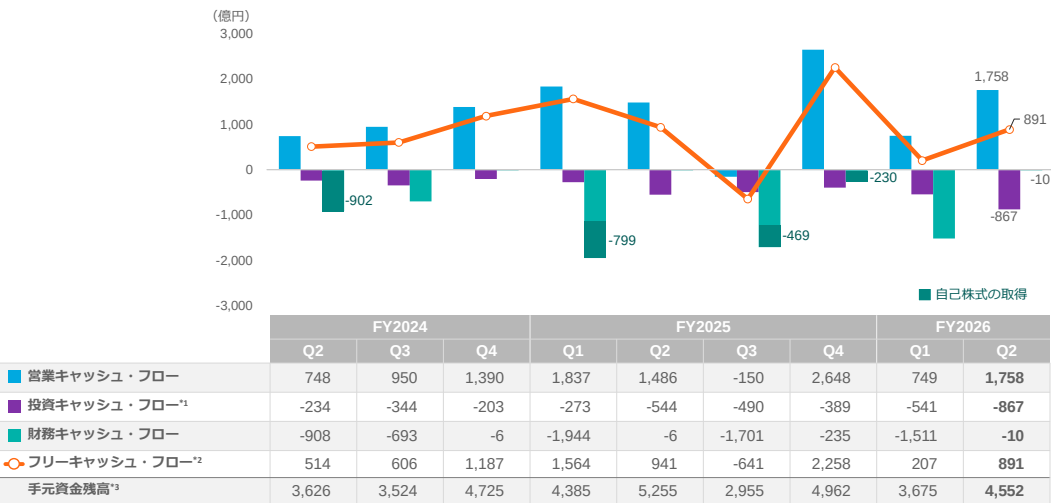
有形固定資産は、先ほどご説明した設備投資等により、前四半期から809億円増加し、5,612億円となりました。

続いて、右側の負債・純資産でございますが、負債は、前四半期から258億円増加の6,623億円となりました。

純資産は、前四半期比1,318億円増加の2兆46億円となりました。

なお、自己資本比率は 74.4%となりました。

キャッシュ・フロー（四半期）



^{*1} 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。
^{*2} フリーキャッシュ・フロー＝営業キャッシュ・フロー＋投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）
^{*3} 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

最後に、「キャッシュ・フロー」をご説明いたします。
この四半期における営業キャッシュフロー獲得は、1,758億円でした。
投資キャッシュフローの支出は、主に、固定資産の取得により、867億円。
財務キャッシュフローの支出は10億円。また、フリーキャッシュフローは、891億円
の収入となりました。
私からのご説明は以上です。ありがとうございました。

事業環境および業績予想

2025年10月31日

代表取締役社長・CEO
河合 利樹



河合でございます。改めまして、本日はご参加いただきありがとうございます。
私からは、「事業環境 および 業績予想」について、ご説明いたします。

事業環境（2025年10月時点でのWFE市場の見方）

■ CY2025：\$115B程度と予測 <変更なし>

AI向けを中心とした最先端Logicと先端DRAMが投資を牽引。
NANDは回復基調も、成熟世代向けは軟調

■ 今後、旺盛なAIサーバー需要に牽引され、先端半導体向け投資は拡大傾向が続くと見込む

- DRAM：HBMのみならず汎用DRAM向け投資も急増。来年以降も二桁成長が期待できる
- NAND：SSD向け需要により顧客の稼働率が上昇中
- ロジック/ファウンドリ：先端向け投資は今後もさらに増加。
アドバンスドパッケージングも進展
- 成熟世代デバイス：現状と同規模程度のWFEが継続すると予測

来年以降、付加価値の高い最新装置の需要拡大を見込む

まず、事業環境についてです。

CY2025のWFE市場は、前回7月時点と変わらず、115Bドル程度と見ています。成熟世代向け投資は全体的に軟調ですが、過去数年抑えられていたNAND向け投資は回復傾向にあり、

何よりも、AI向けを中心とした、最先端のロジックと、先端DRAMが投資を牽引しています。まさに、AI時代の到来です。

旺盛なAIサーバー需要とそれに必要となる半導体の技術革新がドライバーとなり、今後も先端半導体向けの投資は飛躍的な拡大が見込まれます。

DRAMは、HBMのみならず、汎用DRAM向け投資も急増しており、来年以降も二桁成長が期待されます。

NANDも、データセンター向けのSSD、いわゆる、eSSDの需要の高まりとともに、顧客の工場稼働率が上昇しております。

ロジックは、2nm、そして1.4nmへと微細化を伴いながら、今後もさらに投資が増加します。

先端パッケージングやテストのニーズも日増しに加速しており、その重要性は高まる一方です。

また、成熟世代向けは、現状と同規模程度の投資が継続すると予測しています。

これらを背景に、CY2026のWFE市場は、過去最高を更新する市場規模となると見ています。

今後、付加価値の高い最新装置の需要拡大を見込んでいます。

拡大するTELの事業機会 微細化×異種デバイス集積

Etch	>5,000億円	• DRAM配線工程エッチング装置： 特に配線層数の多いHBM向け投資増加により事業機会が拡大。 2030年までに累計5,000億円以上の売上を見込む
Bonder Laser	>5,000億円	• ボンダーをはじめとした3次元実装装置： すべてのアプリケーションにおいて急拡大。 2030年までに累計5,000億円以上の売上を見込む
Prober	CAGR >15%	• AI・HPC向けプローバ： さらなるテスト時間や工程数増加に伴いCAGR15%以上の成長を見込む（CY2025～CY2030）
Die Prober PECVD	SAM +10%	• ダイプローバ： 顧客との開発評価合意。プローバ市場の10～15%のSAM創出 • 埋め込み膜用 枚葉プラズマCVD： PECVD市場の約10%。複数顧客にて評価進捗中

Investor Relations / October 31, 2025

TEL

14

当社は、成長する半導体製造装置市場の中でも、多様な事業機会を得られるよう、戦略的に取り組んでまいりました。

微細化や積層化といった前工程プロセスのみならず、異種デバイスを集積する3次元実装（3D Integration）やテスト事業も持ちあわせており、優位性を築いております。2030年には、半導体市場が1兆ドルに達するというのがコンセンサスとなっていますが、そこに向けたさまざまな技術革新の中で、当社の機会をご紹介しますと、

- エッチングでは、特に配線層数の多いHBM投資の増加により、DRAM配線工程向けで、2030年までに、累計約5,000億円の売上が見込まれます。
- ボンダーをはじめとした3次元実装装置に関しては、前期FY2025は300億円程度の売上でしたが、最先端ロジック、DRAM、NAND、すべてのアプリケーションにおいて、今後急激な拡大が見込まれ、2030年までに、累計5,000億円以上の売上を見込んでいます。
- テストに対する需要は、想像を上回るものがあります。
東京エレクトロンの歴史を振り返ると、プローバが売上の多くを占める時代もありましたが、まさにその勢いさながらです。
- 当社が高いシェアを誇るAI・HPC向けの最先端プローバにおいては、さらなるテスト時間や工程数の増加や、ダイプローバのような新たなテスト手法の導入に伴い、2025年から2030年までの期間で、CAGR15%以上の高い成長率が期待されます。
- 新たな事業への参入、SAMの創出にも注力しています。特に、さきほど申し上げたダイプローバにおいては、プローバ全体の10～15%程度の市場規模が期待されており、このほど、顧客との開発評価の合意に至りました。
- また、次世代以降のロジックにおいては、枚葉式のプラズマCVDにて、Voidフリーの埋め込み膜、いわゆるGapfillが大幅に拡大することが見込まれます。
- PECVDは、現状でも、年間約1兆円の市場規模がありますが、Gapfillは、PECVD市場全体の約10%に成長すると見込まれております。当社はこのたび、下地材料のダメージフリーのGapfill成膜技術の開発に成功し、さまざまな先端顧客とアプリケーションの拡大に向けた評価に着手しております。

これまでご紹介した以外にも、さまざまな案件が順調に進捗しています。

- 低抵抗メタル成膜において、DRAMとNANDの複数顧客で評価が順調に進捗しており、1社からPORを獲得しました。
- 洗浄装置においては、SPM Vapor洗浄や、ウェーハ両面同時洗浄装置など、

シェア拡大につながるアイテムが進捗しています。

- エッチングでは、PORを独占しているDRAM Capacitorの事業機会がさらに拡大します。また、400層世代のNANDの量産投資が来年末から始まり、いよいよ当社の極低温エッチングが量産展開されます。

このように、市場成長、および、シェアの向上により、成長ポテンシャルは大きく広がっています。

これからも、お客様とのエンゲージメント活動や、将来を見据えた研究開発を積極的に推進し、継続的な企業価値の向上に努めてまいります。

2026年3月期 業績予想

(億円)

	FY2025 (実績)	FY2026					ご参考：FY2026 (7/31時点予想)	
		H1 (実績)	H2 (新予想)	通期 (新予想)	vs FY2025	通期修正額*	H2	通期
売上高	24,315	11,796	12,003	23,800	-2.1%	300	12,000	23,500
売上総利益	11,462	5,388	5,401	10,790	-5.9%	130	5,390	10,660
売上総利益率	47.1%	45.7%	45.0%	45.3%	-1.8pts	-0.1 pts	44.9%	45.4%
販管費	4,489	2,357	2,572	4,930	+9.8%	-30	2,570	4,960
研究開発費	2,500	1,348	1,551	2,900	+16.0%	-50	1,550	2,950
研究開発費以外の販管費	1,989	1,009	1,021	2,030	+2.1%	20	1,020	2,010
営業利益	6,973	3,031	2,828	5,860	-16.0%	160	2,820	5,700
営業利益率	28.7%	25.7%	23.6%	24.6%	-4.1pts	0.4pts	23.5%	24.3%
税金等調整前当期純利益	7,061	3,129	3,220	6,350	-10.1%	560	2,860	5,790
親会社株主に帰属する当期純利益	5,441	2,416	2,463	4,880	-10.3%	440	2,200	4,440
1株当たり当期純利益 (円)	1,182.40	527.31	-	1,064.77	-117.63	95.65	-	969.12

* 2025年7月31日に発表した通期業績予想からの修正額を示しています。

上期実績を踏まえ、通期の業績予想を修正。
保有株式の売却に伴う特別利益を反映

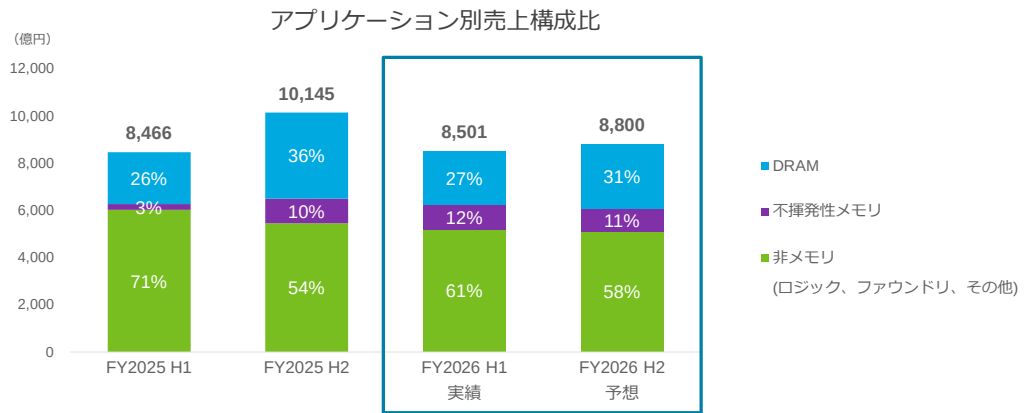
次に、業績予想についてです。上期の実績を踏まえ、通期の業績予想を修正いたしました。

FY2026通期の業績につきましては、ご覧のとおり、売上高 2兆3,800億円、売上総利益率 45.3%、営業利益率は 24.6%を見込んでおります。

なお、第3四半期に入り、一部、保有株式の売却をおこない、特別利益を計上いたしました。

これらを加味し、今期の当期純利益は 440億円上方修正し、4,880億円を計画しております。

2026年3月期 SPE新規装置売上予想



最新業績予想に基づき、アプリケーション別売上構成予想を更新

こちらは、今期 FY2026の SPE新規装置の売上予想です。
今下期の新規装置の売上は、3か月前の予想どおり、上期から微増の、8,800億円となる見込みです。
アプリケーションごとの内訳は、ご覧の通りです。

2026年3月期 研究開発費・設備投資計画

第3開発棟
エッチング装置



宮城県黒川郡
2025年4月 竣工

東北生産・物流センター
成膜装置



岩手県奥州市
2025年秋 竣工予定

プロセス開発棟
コート/デベロッパ、洗浄装置

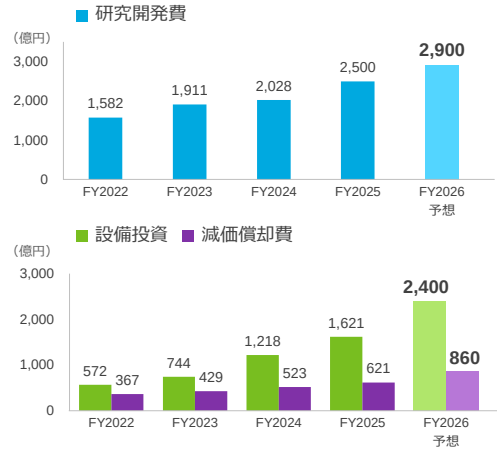


熊本県合志市
2025年10月 竣工

宮城生産革新センター
エッチング装置



宮城県黒川郡
2027年夏 竣工予定



AIサーバー向け半導体が技術革新を牽引し、半導体の需要は拡大。
研究開発・設備投資は予定通り実施

次に、「研究開発費と設備投資の計画」についてです。

今期は、4月に竣工した宮城の新開発棟を皮切りに、今月10月には、熊本の新開発棟が竣工しました。

岩手の生産・物流センターも、来月竣工予定です。

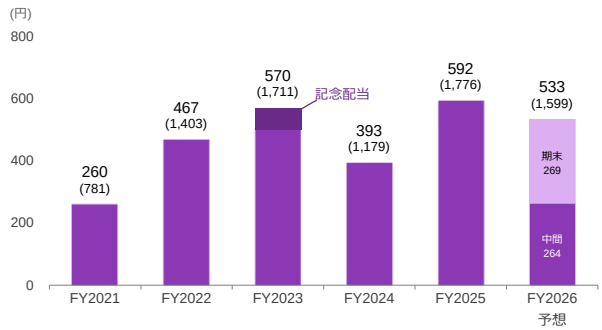
次世代のスマートプロダクション構想を採り入れた、宮城の生産新棟も6月より着工しました。

FY2026の研究開発費は、若干の修正を加え、2,900億円を計画しています。

設備投資、減価償却費は、期初と変わらず、それぞれ、2,400億円、860億円を見込んでおります。

2026年3月期 配当予想

1株当たり配当金



■ FY2021～2023の1株当たり配当額は、FY2021の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
■ FY2023には60周年記念配当が含まれます。
■ 株式分割がおこなわれる以前の金額を（ ）内で記載しています。

当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しています。

1株当たり通期配当は533円を予定

最後に、「配当予想」についてです。
業績予想の修正、および、保有株式の売却による特別利益を加味し、今期の1株当たりの配当は、通期533円を予定しております。
なお、期中の手元資金の状況と、資本効率のバランスを勘案しつつ、機動的に自社株買いの実施を検討してまいります。
私からのご説明は以上です。
ご静聴ありがとうございました。

